

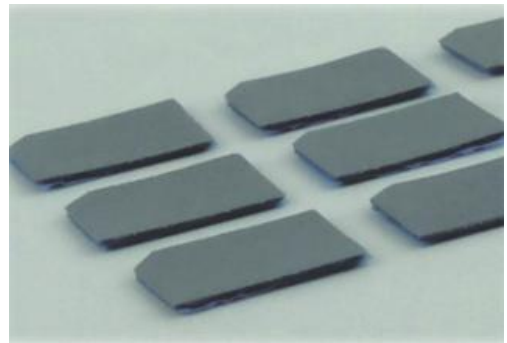
KLEBER GAP PAD Flextein S51

产品介绍

Flextein S51是一种新型的、高导热性能的缝隙填充材料。其导热系数高达5.1W/m.k，是一款专门为高功耗高热量高性能的应用场景而设计的导热材料。除了材料本身的高导热率，还具有良好的压缩性和贴服性，更易紧密贴附于电子元器件上，同时覆盖住微观不平整的表面从而使配合部件充分接触而提高热传导效率。Flextein S51两面具有自然粘性，装配时只需轻轻按压紧，无需背胶即可固定在元器件上。产品的厚度可以在0.5-10.0mm范围内根据客户的需求而定制，也可以选择单面粘性便于使用。

性能及特点

- 导热系数5.1 W/m·K
- 柔软且具有优异的可操作性
- V-0阻燃等级
- 厚度范围 0.02” (0.50mm)至 0.40” (10.0mm)



性能参数

特性	单位	参数	测试标准
颜色	-	灰色	目测
厚度	mm	0.5-10.0	ASTM D374
导热系数	W/m.k	5.1	ISO 22007-2
硬度	Shore OO	55	ASTM D2240
比重	g/cm ³	3.2	ASTM D792
介电强度	KV/mm	≥6.0	ASTM D149
体积电阻率	Ω.cm	≥1.0×10 ¹²	ASTM D257
介电常数	@1MHz	6.5	ASTM D150
渗油率	%	<1	125°C& 48h
连续使用温度	°C	-40-150	Kleber
阻燃特性	-	V-0	94 UL
RoHS	-	Yes	Kleber

典型应用

- 电脑和服务器及其周边
- 智能手机、平板多媒体
- 高端网络设备
- 光通讯模块

产品配制

- 标准尺寸 470×470 mm，可根据顾客的需求裁切
- 标准厚度：0.5mm(0.02")至 10mm(0.4")，以 0.5mm(0.02")递增。可依客户需求定制厚度。
- 可选择双面粘性、单面粘性，可依需求背胶

储存条件

- 常温密封避光，并放置在干燥的地方储存。
- 最佳储存条件：温度 25°C (±3)，湿度 50% (±10)，可保存 12 个月。
- 开封后取出的材料可能在使用的过程中受到污染，不要再将受污染的产品与未开封的产品混合放置。科蓝柏公司不对被污染的产品或要求的储存条件以外的情况承担责任。
- 如需其他信息，请及时联系您对接的销售、技术支持或者客服人员。

声明

本技术数据表 (TDS) 中提供的信息 (包括产品使用和应用建议) 基于我们对科蓝柏产品的了解和经验。此TDS包含的数据仅供参考，并被认为是可靠的。我们不能对他人因我们无法控制的方法而获得的结果承担责任。该产品在您的环境中可以有各种不同的应用以及不同的工作条件，这是我们无法控制的。因此，科蓝柏公司对产品是否适合您使用它们的生产过程和条件以及预期的应用和结果不承担任何责任。我们强烈建议您在产品使用前事先进行试验以确认产品的适用性。